

关于天水华天科技股份有限公司
截至 2012 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、关于前次募集资金使用情况的专项报告	3-8
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）	
四、签字注册会计师资格证书（复印件）	

地 址：北京市海淀区西四环中路 16 号院
2 号楼 4 层
[http:// www. chcnpcpa. com](http://www.chcnpcpa.com)

邮 编：100039
电 话：(010) 8821 9191
传 真：(010) 8821 0558

前次募集资金使用情况鉴证报告

国浩核字[2013]第 209A001 号

天水华天科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的天水华天科技股份有限公司（以下简称“华天科技公司”）截至 2012 年 12 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》进行了鉴证。

一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是华天科技公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华天科技公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《关于前次募集资金使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，华天科技公司的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》已按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）编制，在所有重大方面反映了截至 2012 年 12 月 31 日止华

天科技公司前次募集资金的使用情况。

五、特别声明

本鉴证报告仅供华天科技公司向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券之目的使用，不得用作其他任何目的。我们同意将本报告作为华天科技公司申请公开发行可转换公司债券所必备的文件，随其他文件一起上报。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：韩旺

中国·北京

中国注册会计师：宫岩

二〇一三年二月二十二日

天水华天科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》要求，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）对前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]889号《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于2011年10月以非公开的方式发行人民币普通股（A股）32,900,000股（每股面值1元），每股发行价格为人民币11.12元，募集资金总额为365,848,000.00元，扣除各项发行费用15,330,000.00元后，募集资金净额为人民币350,518,000.00元。该项募集资金已于2011年10月21日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2011]703A173号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》。2011年11月4日公司分别与交通银行股份有限公司天水支行、国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2011年11月7日，公司通过募集资金专户向全资子公司华天科技（西安）有限公司（以下简称“西安公司”）增资133,000,000.00元，用于其进行募集资金投资项目“集成电路高端封装测试生产线技术改造项目”建设。

西安公司为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，2011年11月8日与昆仑银行股份有限公司西安分行和国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用情况进行监督，保证专款专用。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2012年12月31日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2012年12月31日，公司累计使用募集资金352,051,496.81元，募集资金专项账户余额（含利息）为142.82元。募集资金存款利息累计为1,497,639.63元，其中：公司账户为179,287.71元，西安公司账户为1,318,351.92元。

截至2012年12月31日，使用金额包含了公司账户收到已支付的利息179,144.89元，西安公司账户收到已支付的利息1,318,351.92元。

截止2012年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：（人民币）元

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息收入净额	定期存款转入	已使用金额	存储余额
天水华天科技股份有限公司	交通银行股份有限公司天水支行	729030110018010012838	217,518,000.00	179,287.71		217,697,144.89	142.82
华天科技（西安）有限公司	昆仑银行股份有限公司西安分行营业部	79102000048580000038	63,000,000.00	1,318,351.92	70,000,000.00	134,318,351.92	
		79102000048580000120	3,000,000.00		-3,000,000.00		
		79102000048580000108	3,000,000.00		-3,000,000.00		
		79102000048580000146	2,000,000.00		-2,000,000.00		
		79102000048580000061	5,000,000.00		-5,000,000.00		
		79102000048580000053	30,000,000.00		-30,000,000.00		
		79102000048580000046	15,000,000.00		-15,000,000.00		
		79102000048580000087	5,000,000.00		-5,000,000.00		
		79102000048580000079	2,000,000.00		-2,000,000.00		
79102000048580000095	5,000,000.00		-5,000,000.00				
合计			350,518,000.00	1,497,639.63		352,015,496.81	142.82

因募集资金项目实施需要，2012年度西安公司将募集资金定期存款70,000,000.00元转入募集资金专户79102000048580000038账户用于支付项目款。

二、前次募集资金使用情况说明

根据公司2010年12月22日召开的第三届董事会第六次会议、2011年2月15日召开的2011年第一次临时股东大会相关决议，此次募集资金用于“铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化”项目、“集成电路高端封装测试生产线技术改造”项目和“集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造”项目。

截止2012年12月31日，公司募集资金的实际使用情况见下表：

(一) 前次募集资金使用情况对照表

单位：(人民币)元

募集资金总额：			350,518,000.00	已累计使用募集资金总额			352,015,496.81							
变更用途的募集资金总额：			0.00	各年度使用募集资金总额			352,015,496.81							
变更用途的募集资金总额比例(%)：			0.00	2011年：			278,378,535.38							
				2012年：			73,636,961.43							
投资项目		募集资金投资总额					截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可使用状态日期		
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额			募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
					实际已支付投资金额	尚需支付投资金额	合计			实际已支付投资金额	尚需支付投资金额			合计
1	铜线集成电路封装工艺升级产业化	铜线集成电路封装工艺升级产业化	201,600,000.00	112,144,073.02	112,144,073.02	0.00	112,144,073.02	201,600,000.00	112,144,073.02	112,144,073.02	0.00	112,144,073.02	0.00	2012年年底
2	集成电路高端封装测试生产线技术改造	集成电路高端封装测试生产线技术改造	298,400,000.00	133,000,000.00	134,318,351.92	0.00	134,318,351.92	298,400,000.00	133,000,000.00	134,318,351.92	0.00	134,318,351.92	1,318,351.92	2013年年底

3	集成电路封装测试生产线工艺升级改造	集成电路封装测试生产线工艺升级改造	299,000,000.00	105,373,926.98	105,553,071.87	0.00	105,553,071.87	299,000,000.00	105,373,926.98	105,553,071.87	0.00	105,553,071.87	179,144.89	2013年10月
合计			799,000,000.00	350,518,000.00	352,015,496.81		352,015,496.81	799,000,000.00	350,518,000.00	352,015,496.81		352,015,496.81	1,497,496.81	-
未达到计划进度原因			“集成电路高端封装测试生产线技术改造”项目和“集成电路封装测试生产线工艺升级改造”项目还在实施过程中，投资效益将在2013年逐步体现。											
项目可行性发生重大变化的情况说明			无											
募集资金投资项目实施地点变更情况			无											
募集资金投资项目实施方式调整情况			无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金239,561,984.66元。该笔资金已全部置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			募集资金投资项目尚在实施过程之中。											
募集资金其他使用情况			无											

注：募集资金承诺原投资总额为799,000,000.00元；2011年10月21日公司实际募集资金净额为350,518,000.00元，公司根据实际募集资金净额确定的募集资金投入总额调整为350,518,000.00元。

（二）前次募集资金投资项目变更情况

前次募集资金投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况

前次募集资金项目承诺投入总额 350,518,000.00 元，实际投资总额 352,015,496.81 元，实际投资总额与承诺相差 1,497,496.81 元，差额为募集资金专户产生的存款利息用于支付项目款。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）前次募集资金投资项目对外转让、置换及其他使用情况

不存在募集资金投资项目对外转让、置换及其他使用的情况。

（六）尚未使用的募集资金使用计划和安排

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为 142.82 元，为募集资金存款利息，将用于支付集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造项目设备款。

三、前次募集资金投资项目最近两年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：（人民币）万元

实际投资项目 项目名称	截止 2012 年 12 月 31 日投 资项目累计 产能利用率	承诺达产 后年效益	最近两年实际效益		截止日累计 实现效益	是否达到预 计效益
			2011 年度	2012 年度		
铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化	98.03%	3,250.00	1,673.98	2,666.94	4,340.92	否
集成电路高端封装测试生产线技术改造	见注 1	5,193.00		891.47	891.47	不适用
集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造	见注 1	5,463.00		1,149.79	1,149.79	不适用
合计		13,906.00	1,673.98	4,708.20	6,382.18	

注 1：截至 2012 年 12 月 31 日，公司上述募集资金投资项目尚处于建设期，项目总体未达到预定可使用状态，故无法计算投资项目累计产能利用率；

注 2：实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目实现效益的情况说明

铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化项目已全部提前实施完成，截至 2012 年 12 月 31 日，累计实现效益 4,340.92 万元，2012 年度项目实现效益为“承诺达产后

年效益”的 82.06%。

截至 2012 年 12 月 31 日，集成电路高端封装测试生产线技术改造项目完成投资 16,512.88 万元，占项目总投资的 55.34%。实现效益 891.47 万元，占“承诺达产后年效益”的 17.17%。实现效益低于预计效益的原因为项目只是已实施部分投产，目前该项目正在实施之中，按计划于 2013 年底实施完成，投资效益将在 2013 年后逐步释放。

截至 2012 年 12 月 31 日，集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造项目完成投资 25,742.90 万元，占项目总投资的 62.18%。实现效益 1,149.79 万元，占“承诺达产后年效益”的 21.05%。实现效益低于预计效益的原因为项目只是已实施部分投产，目前该项目正在实施之中，按计划于 2013 年底实施完成，投资效益将在 2013 年后逐步释放。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司在前次募集资金使用过程中，未涉及以资产认购股权情况。

五、前次募集资金的使用情况与公司年度报告及其他信息披露文件中披露的有关内容完全一致。

天水华天科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月二十二日